: GETEC-C1-09-135

APPENDIX J

: ANTENNA SPECIFICATION

EUT Type: Bluetooth handsfree car kit

FCC ID.: XGVBCX-300



Halogen free



MSL Level 1

ROHS-Y

승 인 원

제 품 명	칩 안테나					
사 용 자	(주) 유엔비텍					
적 용 모 델		BCX-300				
사용자 CODE						
공급자		주식회사 파트론				
공급자 CODE		ACS2450JBARD2				
	작성자	검토자	승인자			
(주) 유엔비텍						
	/	/	1			
	작성자	품질합의	승인자			
(주)파트론	with	Strike	例从			
	연구 5팀	품질보증파트	연구소			
	전찬익	민남식	임병준			
	05 / 07	05 / 07	05 / 07			

2009. 05. 07



445-170, 경기도 화성시 석우동, 22-6

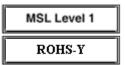
Tel: 031-201-7870~6 Fax: 031-201-7800 www.partron.co.kr

Ver 1.0 (2009.05.07) 1/31 page









SPECIFICATION

MODEL: ACS2450JBARD2



2009. 05. 07



445-170, 경기도 화성시 석우동, 22-6

Tel: 031-201-7870~6 Fax: 031-201-7800 www.partron.co.kr

Ver 1.0 (2009.05.07) 2/31 page



- 목 차 -

※ 五지	1 p
※ 목차	3 р
1. 이력 관리	····· 4 p
2. 부품의 개요 및 치수규격	5 p
3. 중점 관리 항목	5 р
4. 전기적 특성	6 р
5. 시험 방법	······ 11 p
6. 내부 회로 구성도	13 p
7. 기본 동작 및 응용방식	13 р
8. 측정 지그 사양	14 p
9. REFLOW PROFILE	15 р
0. 초기 검사 성적서	16 р
1. 신뢰성 보증 조건	17 p
2. 기구적 특성	18 р
3. 구조 및 재질	20 p
4. 주의 사항	21 p
5. 포장 사양	22 p
6. 관리 공정도	26 p
7. 유해물질 성적서	29 p



1. 이력관리

개정번호	개발자	변경사항	변경일자
Ver 1.0	전찬익	승인원 제정	2009.05.07



2. 부품의 개요 및 치수 규격

2.1 부품개요

본 제품은 유전체 무선 통신 기기 내장형 칩 안테나로 직방의 형상을 갖는 유전체에 은(Ag) 도금으로 패턴을 형성하여 특성을 구현한다.

2.2 부품 치수규격

형 태	Only Bulk Ceramic				
재 질	유전체	Mg₂SiO₄(Magnesium Silicate)			
세 글	전극 도금	은(Ag)			
	$W = 2.5 \pm 0.1$				
크 기 [mm]	$L = 10.0\pm0.1$	Ag Paste			
	T = 1.2±0.1	W			
평탄도	0.04(소체기준)	T			
MSL LEVEL	MSL LEVEL 1				
ESD LEVEL	15 KV 이상 (HBM CLASS 3B)	Top - Side View Block Bottom Side View			
Version	Revision 1.0				

3. 중점관리항목(👓)

- 아래 항목에 대하여 중점관리 항목으로 지정하여 관리한다.

제품의 CTQ 항목	지정 사유
성형무게, 치수	성형무게 및 치수에 따라 소성 후 소체 크기가 결정되며 소체 크기가 인쇄 정밀도에 영향을 미침
소성치수	소성 후 치수가 인쇄 정밀도에 영향을 줌
인쇄치수	인쇄치수 정밀도가 블루투스 안테나의 특성의 핵심적 항목임

제품의 CTF 항목	지정 사유
단품 측정 정재파비	제품의 전기적 특성을 분별하는 주요 변수임

- 아래 항목에 대하여 주의를 요함.

항 목	내 용
보 관	상온에 장시간 보관 시 밀봉하여 보관
동 작	임의의 설계 변경 시 특성이 변경될 수 있음

Ver 1.0 (2009.05.07) 5/31 page



4. 전기적 특성

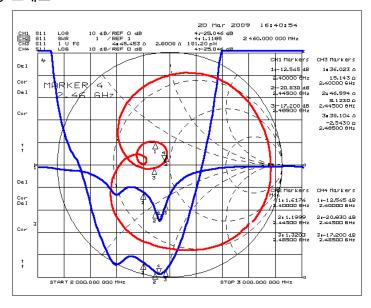
4.1 시료 실장 측정

	항	목	특 성		
주파수 범위 [MHz]			2400 ~ 2485		
	정재파비	l [Max]		3.0 : 1(Typ 2.5 : 1)	
	입력 임피	던스 [Ω]		50 Ohm	
	편 ⁱ	파		Linear	
	Total Gair	n (Peak /	Avg) [dBi]	-0.5 / -4.7	
		Thata	Peak	-1.51	
	Azimuth	Theta	Average	-5.90	
		Phi	Peak	-0.53	
			Average	543	
	Elevation 1	Theta	Peak	-1.83	
이득 [dBi]			Average	-4.47	
		-	Peak	-2.97	
		Phi	Average	-7.76	
		Thata	Peak	-4.58	
		Theta	Average	-9.59	
	Elevation 2	51.	Peak	-2.29	
	Phi		Average	-5.50	

Ver 1.0 (2009.05.07) 6/31 page



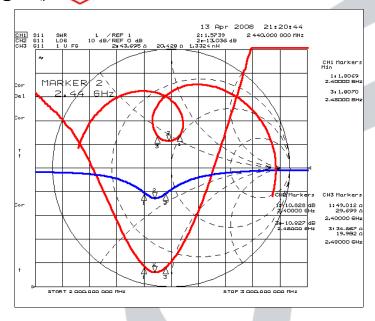
4.2 시료 실장 측정 그래프



4.3 Test Fixture 측정

항 목	특 성		
주파수 범위 [MHz]	2400 ~ 2480		
Lower frequency(2400MHz) 정재파비 [Min~Max]	1.0~3.0 : 1(Typ 2.5 : 1)		
Upper frequency(2480MHz) 정재파비 [Min~Max]	1.0~3.0 : 1(Typ 2.5 : 1)		

4.4 Test Fixture 측정 그래프 📀

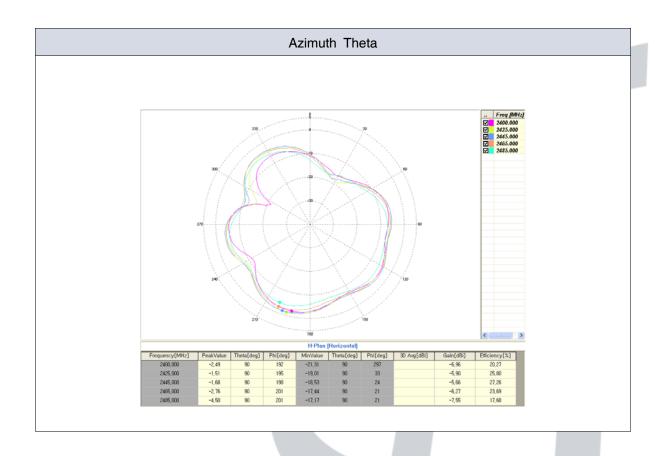


Ver 1.0 (2009.05.07) 7/31 page



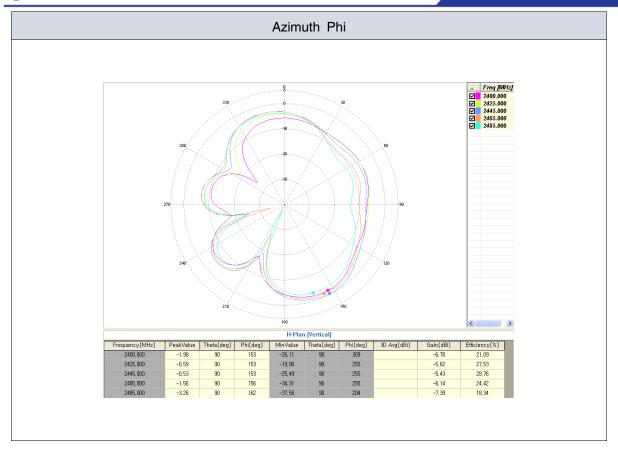
4.5 방사 패턴

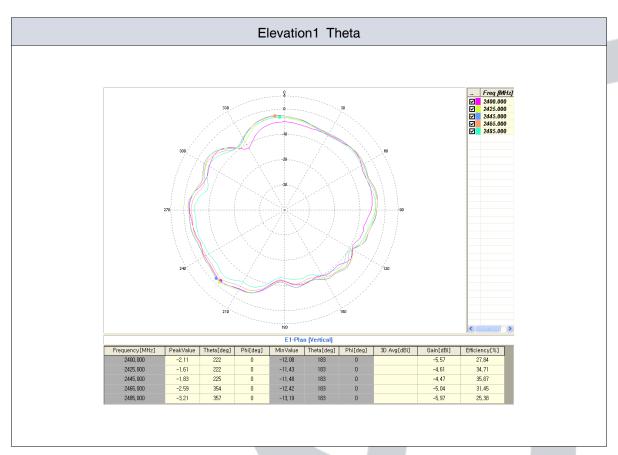
Azimuth Plane	Elevation1 Plane	Elevation2 Plane	
270° 90°	90° 270°	270° 90° 180°	
Theta	Vertical field of	measured plane	
Phi	Horizontal field of measured plane		



Ver 1.0 (2009.05.07) 8/31 page

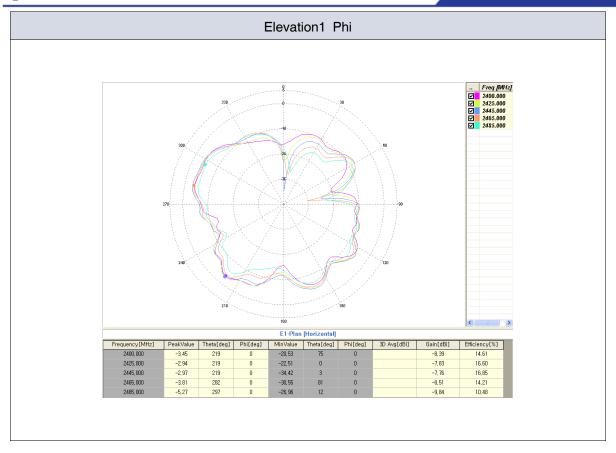


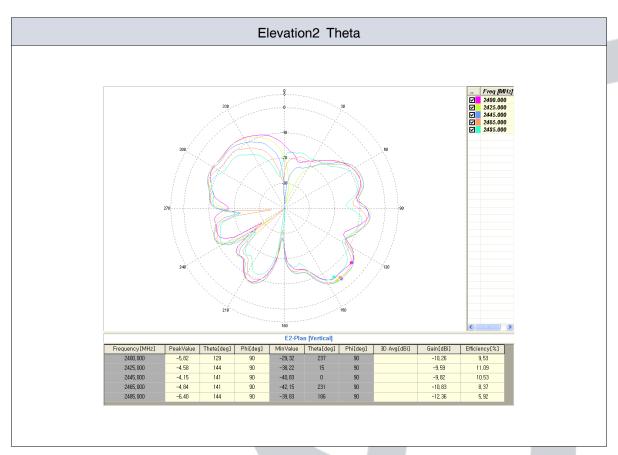




Ver 1.0 (2009.05.07) 9/31 page

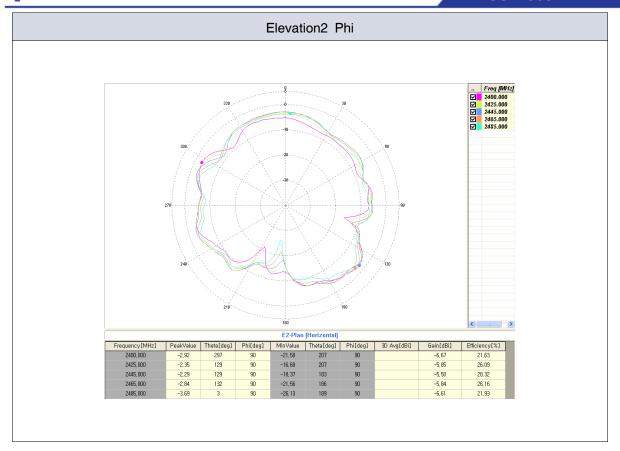






Ver 1.0 (2009.05.07) 10/31 page





5. 시험 방법

5.1 정재파비 / 반사손실

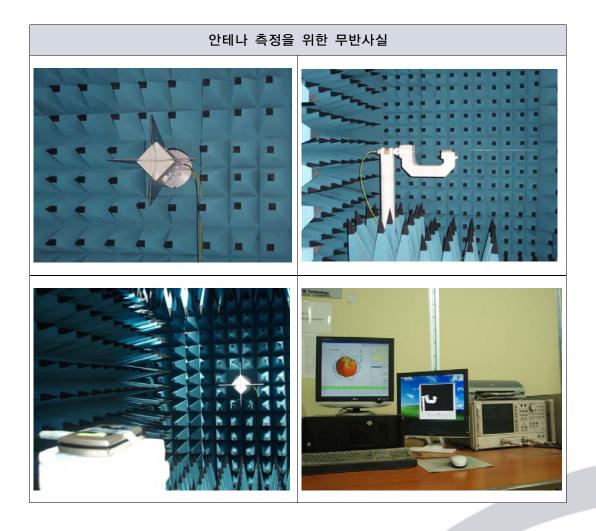
Network Analyzer를 이용하여 정재파비/반사손실을 측정하며 표본 샘플을 선별 Test Fixture 또는 자동화 검사장비를 이용하여 양품과 불량품을 선별한다.

	Set Condition	Test Fixture Condition		
Network Analyzer	Agilent HP8753E	Agilent HP8753E or Advantest R3765CH		
Cable	RF cable(300mm)	RF cable(300mm)		
Test condition				

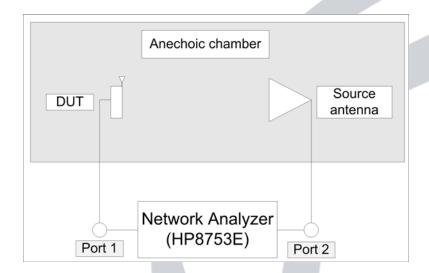
5.2 이득



당사가 보유한 전파 무반사실에서 상기 4.1에서 측정된 시료를 이용하여 안테나 이득을 측정한다.



5.3 이득 측정을 위한 회로 구성도

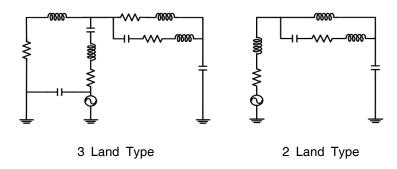


Ver 1.0 (2009.05.07) 12/31 page



6. 내부 회로 구성도

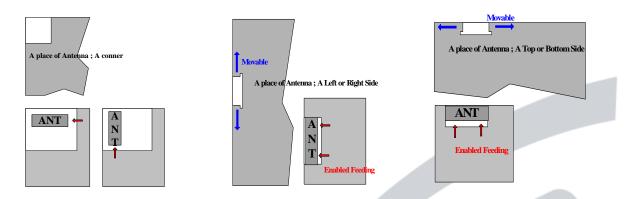
본 제품은 유전체를 재료로 한 직방형의 소체 표면에 은(Ag) 패턴의 구조적인 변경을 통하여 아래와 같은 구조적인 등가회로의 매칭 값을 조절하여 성능을 구현하는 RF 부품이다.



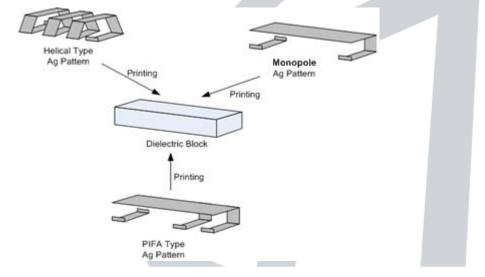
7. 기본 동작 및 응용 방식

본 제품은 무선 통신 기기 내장형 유전체 칩 안테나로 전송선로를 따라 진행해 온 전기적 신호를 자유공간파(FREE SPACE WAVE) 로 변환하는 장치이다.

본 제품은 원하는 어떠한 위치에도 실장이 가능하며 실장 조건에 따라 그 설계를 달리 한다. 다만 본 제품은 방사 부품으로 주변 경계 조건에 따라 그 특성을 달리 하므로 위치 선정에 각별한 주의를 기울여야 한다.



본 제품은 실장 주변 조건에 맞추어 아래와 같이 다양한 안테나 형태로 설계 변경이 용이하다.



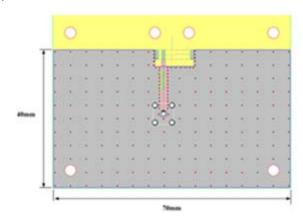
Ver 1.0 (2009.05.07) 13/31 page



8. 측정 지그 사양

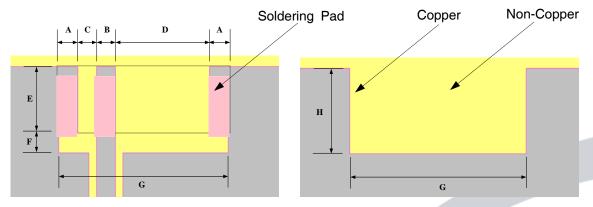
8.1 Test Fixture And GROUND Condition





※ Ev B'd 와 Test fixture 지그는 동일함.(Ev B'd는 접촉 방식이 납땜, Test Fixture는 동편 접촉 방식)

8.2 PCB Layout & Soldering 패드 치수



Top Layout

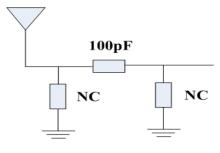
Bottom Pattern

Parameter	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
Value[mm]	1.1	1.0	1.0	6.0	2.7	1.0	10	3.7

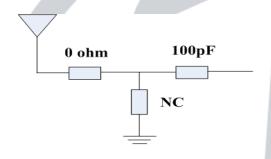
Unit; mm

Unless specified tolerances are ±0.05





π Matching



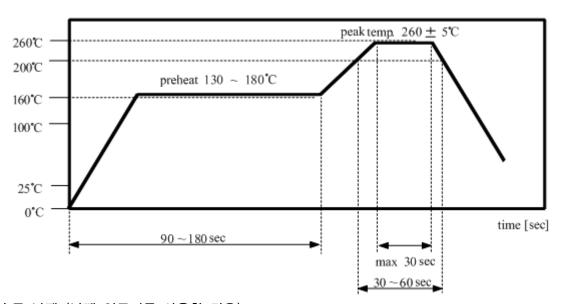
T Matching

Ver 1.0 (2009.05.07) 14/31 page



9. REFLOW PROFILE

9.1 표준 열경화(Reflow) 조건



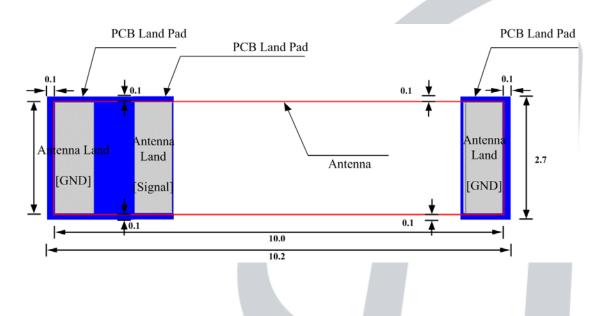
9.2 수동 납땜 (납땜 인두기를 사용할 경우)

예 열: 120℃ / 시 간: 60 ~ 300 sec. 인두온도: 340℃±5℃ / 시 간: 각 단 최대 5 sec.

9.3 PCB 패턴 설계 제안

PCB Land 패턴은 제시한 안테나의 land 치수보다 아래 그림에서 보여지는 것과 같이 0.1mm 이상 외각으로 확장된 형태로 설계된다.

* 8.2 PCB Layout & Soldering 패드 치수 항목과 동일함.



Ver 1.0 (2009.05.07) 15/31 page



10. 초기 검사 성적서

검사항목	단품 특성 [MHz] 🍑			치수 [mm]	
	정재파비 2.5 Max				
규격	2400 [MHz]	2480 [MHz]	W=2.5±0.1	L=10.0±0.1	T=1.2±0.1
1	1.86	1.78	2.52	10.01	1.22
2	1.88	1.79	2.53	10.02	1.23
3	1.87	1.83	2.53	10.03	1.23
4	1.88	1.72	2.53	10.01	1.23
5	1.84	1.82	2.52	10.01	1.22
6	1.72	1.81	2.54	10.01	1.24
7	1.85	1.97	2.52	10.02	1.22
8	1.86	1.88	2.53	10.02	1.23
9	1.83	1.86	2.52	10.02	1.21
10	1.81	1.79	2.53	10.02	1.23
11	1.80	1.77	2.53	10.03	1.23
12	1.81	1.88	2.52	10.03	1.22
13	1.79	1.85	2.54	10.02	1.24
14	1.90	1.92	2.52	10.01	1.22
15	1.86	1.89	2.53	10.01	1.23
16	1.86	1.81	2.53	10.02	1.21
17	1.87	1.78	2.52	10.03	1.22
18	2.07	1.93	2.54	10.03	1.24
19	1.87	1.87	2.52	10.01	1.22
20	1.95	1.83	2.52	10.02	1.22
Min	1.72	1.72	2.52	10.01	1.21
Max	2.07	1.97	2.54	10.03	1.24
Х	1.85	1.83	2.52	10.01	1.22
σ	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01
Cpk	4.12	4.47	3.28	3.38	2.76
판정	OK	ОК	ОК	ОК	ОК

Ver 1.0 (2009.05.07) 16/31 page



11. 신뢰성 보증조건

11.1 환경 시험

항 목	시 험 조 건	판정기준
PCT	+121 [℃] ±5 [℃] , RH=100%, 96hr	
저온동작	-40℃±3℃에서 1시간 방치 후 시험온도 상태에서 측정한다	
저온방치	-40℃±3℃, 120hr±2hr 방치한다.	시험 후 4.4항의 특성 규격을 만족해야 함
내습동작	+85±3℃, RH85%에서 1시간 방치 후 시험온도 상태에서 측정한다.	
내습방치	+85±3℃, RH85% , 120hr±2hr 방치한다.	

11.2 열충격, REFLOW시험

항 목	조 건	판정기준
여동거	조 건: -40℃±3℃/1min ↔ +85℃±3℃/1min	
열충격	시험 CYCLE : 32 cycle 온도변환시간 : 5min 미만일 것.	시험 후 4.4 항의 특성
	Pre Heating : 200±5℃, 30~60 sec	규격을 만족해야 함
Reflow	Peak Heating : 260℃±5℃, 30sec Max 초기측정 후 1회, 환경시험 후 3회 실시	

11.3 기계적 시험

항 목	조 건	판정기준
진동시험	주파수 : 10~500Hz, 가속도 : 10×9.8㎢(G) Sweep time : 15min, X.Y.Z each 5 times	
낙하시험	 조건: 152cm에서 낙하 지그를 이용하여 18회 자유낙하 (6면3회) 지그: 120g±20g 플라스틱 지그 사용 바닥: 콘크리트 또는 철판 	시험 후 4.4 항의 특성 규격을 만족해야 함

*진동 및 낙하시험은 Ev B'd 납땜하여 실시할 것.

11.4 MSL LEVEL 시험

1) JEDEC J-STD-020C 조건

	Floor Life		Soak Requirements	
	Time	Conditions	Time	Conditions
1	Unlimited	= < 30°C/85%RH	168+5/-0	= < 85℃/85%RH

2) Test 조건

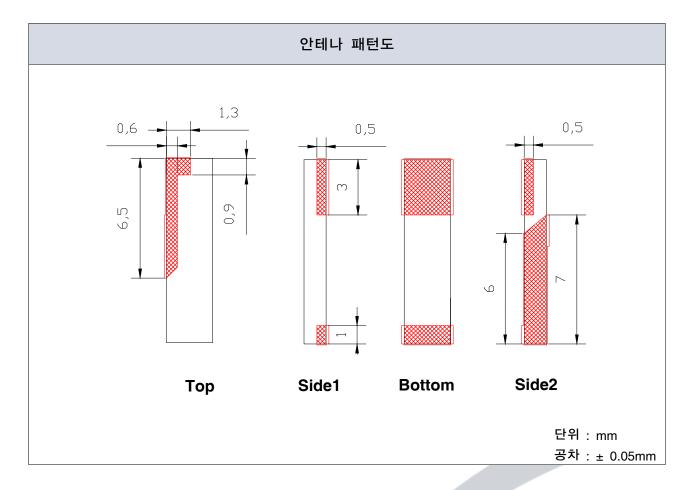
항목	조 건	비고
Soak Requirements	+85±3 [°] C, RH85%, 168hr±2hr 방치 후 Aging없이 Reflow 실시 3회 실시	시험 후 4.4 항의 특성 규격을 만족해야 함

Ver 1.0 (2009.05.07) 17/31 page

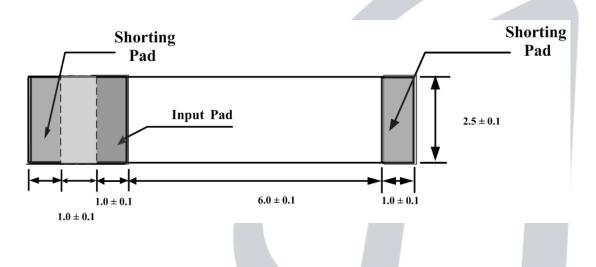


12. 기구적 특성

12.1 안테나 패턴 도면



12.2 Pin name



Ver 1.0 (2009.05.07) 18/31 page



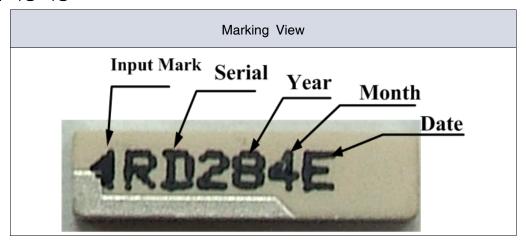
12.3 LOT 번호 표기법

<u>8</u> <u>4</u> <u>E</u>

1 2 3

- ① 연도:8-2008년 ····
- ② 월 : 1 1월, 2 2월 ···· 9 9월, A 10월, B 11월 ····
- ③ 일:1-1일,2-2일···· A-10일, B-11일····

12.4 마킹 사양



▼ RD2 8 4 E

- 1 2 3 4 5
- ① 안테나 급전 방향
- ② 모델 약자
- ③ 연도: 1-2001, 2-2002, ···· 8-2008 ····
- ④ 월 : 1 1월, 2 2월 ···· 9 9월, A 10월, B 11월 ····
- ⑤ 일: 1-1일, 2-2일 ···· A-10일, B-11일 ····

12.5 마킹 종류

잉크 마킹 - 검정 잉크 사용

Ver 1.0 (2009.05.07) 19/31 page

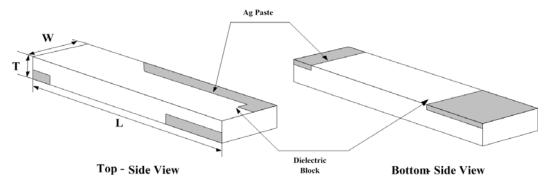


13. 구조 및 재질

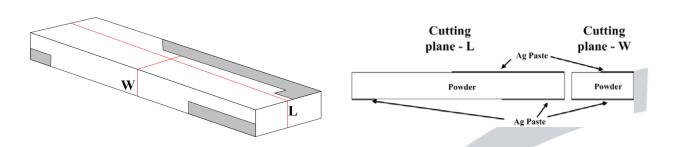
13.1 구현방법

직방체의 형상을 갖는 유전체 소체에 은(Ag) 도금으로 패턴을 형성하여 특성을 구현함.

13.2 구 조



13.3 내부 단면도



13.4 재 질

구 분	재질	제조사	인쇄패턴 사양
직방체	POWDER	후지	
패턴	은(Ag) 도금	대주전자	인쇄두께 : TYP 10/4 ^m
패드	은(Ag) 도금	대주전자	인쇄두께 : Min10㎞(TYP 16~20쎠)

Ver 1.0 (2009.05.07) 20/31 page



14. 주의 사항

14.1 온도조건

	온도범위	unit
사용온도	-40 ∼ +100℃	${\mathbb C}$
보관온도	-40 ~ + 70℃	°C

14.2 온도조건 TEST 조건

	항목	온도범위
사용온도	저온	-75℃에서 24시간 정상동작
	고온	+150℃에서 24시간 정상동작
보관온도	저온	-75 [°] 에서 1000HR 방치 시 정상동작
	고온	+85℃에서 1000HR 방치 시 정상동작

* 고온방치 시 포장재 보관온도 문제로 85℃ 이상 불가함.



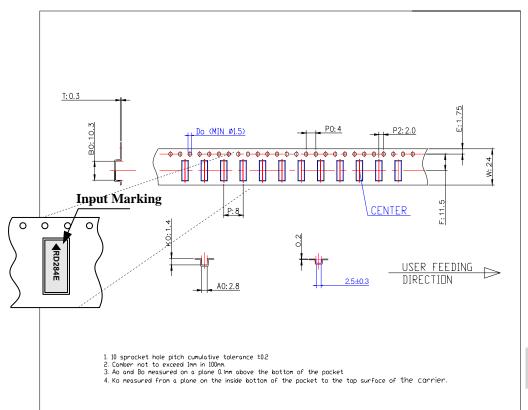
Ver 1.0 (2009.05.07) 21/31 page



15. 포장 사양

15.1 Carrier/Reel 사양

품목	재질	표면저항	정전기 발생량	포장방식
Carrier tape	A-PET	Typical 10 ⁸ Ω	10V MAX	열 압착식
Cover tape	PET	Typical 10 ⁸ Ω	30V MAX	글 급역역
Reel	PS	Typical 10 ⁸ Ω	30V MAX	_

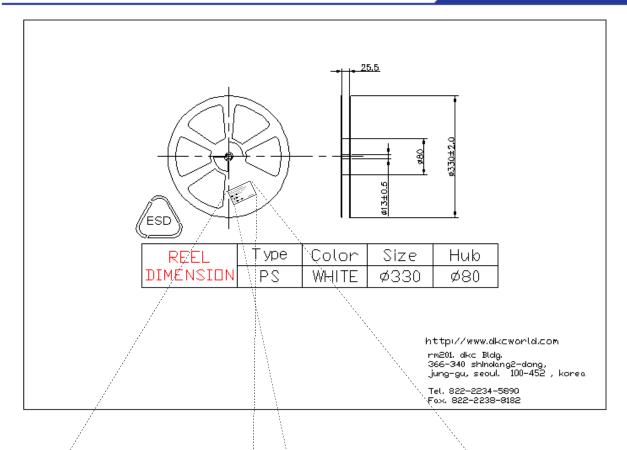


DKC DWG. No	١,	D-2408-005
DIMENSIONAL UNIT		ММ
UNTOLERANCE DIMENSION	UNTOLERANCED DIMENSION	
CAD FILE NA	ME	041211
DESIGNED BY	,	К. М. С
SCALE		1/1
	CARRIEF 2.5*10	
PART.	CAR	RIER TAPE
MATERIAL		A-PET
LENGTH		49.2M
COUNT		6150P

NAME	SPEC.
W	24.0±0.2
E	1.75±0.1
F	11.5±0.1
Do	1.5+0.1
Р	8.0±0.1
Ро	4.0±0.1
P2	2.0±0.1
Ao	2.8±0.1
Во	10.3±0.1
Ko	1,4±0.1
Т	0.3±0.05

Ver 1.0 (2009.05.07) 22/31 page





Model: ACS2450JBARD2

PARTRON.

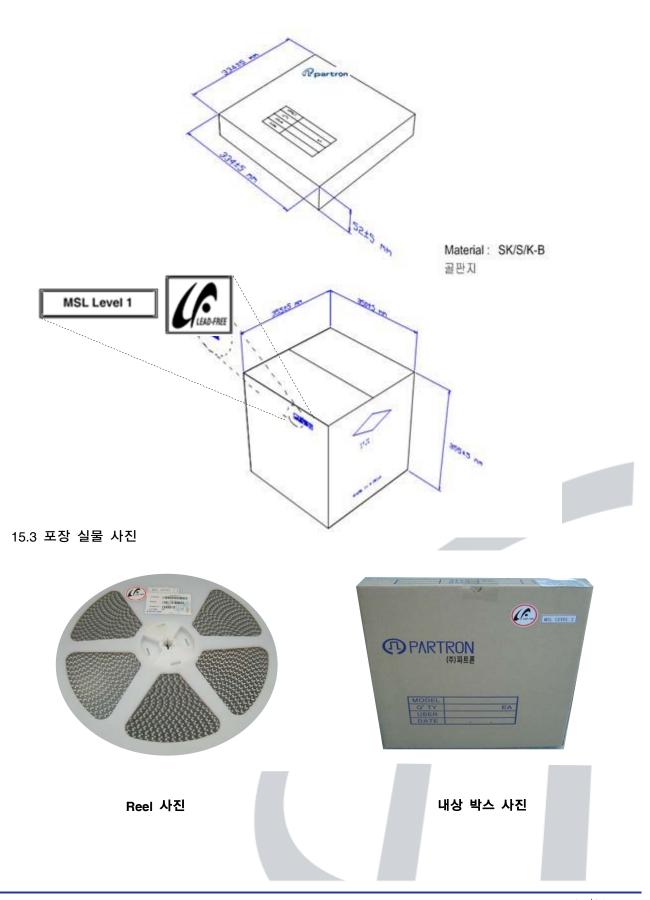
MSL Level 1



Ver 1.0 (2009.05.07) 23/31 page



15.2 박스 사양



Ver 1.0 (2009.05.07) 24/31 page





외상 박스 사진

ACS 2450JBARD2

MODEL:

SO00

QUANTITY:

DATE: 84E

MSL LEVEL 1

Reel / 내상 박스 라벨

FROM
PARTRON.CO.LTD
SEOKWOO.DONG 22-6
HWASEONG - SI
GYEONGGI - DO
445-170.KOREA



CODE NO:

MODEL: ACS2450JBARD2



QUANTITY: 30000



DATE: 2008/04/02

LOT NO: 84E

CHIP ANT

Ppartron

외상 박스 라벨





16. 관리공정도

제품	발행 /개정			관리번호	기안	심의	결정
CHID ANTENNA	Issued	04.04.06	품질관리공정도	DDCD C001			
CHIP ANTENNA	Revised 05.04.03			PRCP-C001			

			Tieviseu	03.04.0											
	FLOW	CHART				요인관리			품질특성관리						
투입자재	준비	본공정	공정명	설비명	관리항목	조건	관리주기	기록관리	관리항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록 관리	조치 사항	
세라믹 파우더		\Diamond	수입검사						수축율 유전율	작업지도서 참조	Micrometer Network	10개/LOT	C/sheet	반품	
파우더 윤활제			분말	Mixer					혼합	파우더:윤활제	저울	혼합시	_	폐기	
			성형 CTQ공정 (무게,치수)	프레스	양압 금형상태	작업지도서 참조	매LOT 1회/일	parameter C/SHEET	치수 무게 밀도 외관	작업지도서 참조	Micrometer 저울 Calculated Visual	5/100개검사 10개/LOT	LOT CARD	폐기	
			소성	소성로	SETTER 외관 온도 PROFILE	작업지도서 참조	전수 2회/일 1회/월	C/sheet							
		\Diamond	소체 CTQ공정 (치수)						폭 길이 모양	검사지도서 참조	Micrometer Calipers 목시	20개/LOT 20개/LOT 전수	C/sheet	폐기	
AG PASTE			SIDE1 PAD 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 속도 /압력 SNAP	작업지도서 참조	1회/일	_	PATTERN 치수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	10개/3Jig	c/sheet	재작업	
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업	

Ver 1.0 (2009.05.07)





CHIP ANTENNA				발행 /개정							관리번호	기안	심의		결정
				Issued 04.04.06. Revised 05.04.03			품질관리공정도				PRCP-C001				
	FLOW	CHART				요인관리					품질특성관리				
투입자재	준비	본공정	공정명	설비명	관리항	남목	조건	관리주기	기록관리	관리항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록 관리	조치 사항
AG PASTE			SIDE 2 PAD 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 : /압력 SNAF	속도 ^력 P	작업지도서 참조	1회/일	_	PATTERN차수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	10개 /3Jig	c/sheet	재작업
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt speed		작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
			소부	소부로 mesh망	온도 Belt spe		작업지도서 참조	1회/주	Parameter C/Sheet	소체파손 오염	작업지도서 참조	목시	전수	Lot card	폐기 재작업
AG PASTE			TOP 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 : /압력 SNAF	속도 ^력 P	작업지도서 참조	1회/일	_	PATTERN치수	작업지도서 참조	측정기	10개 /3Jig	c/sheet	재작업
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt spe		작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
AG PASTE			BOTTOM PAD 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 : /압력 SNAF	속도 ^념 P	작업지도서 참조	1회/일	-	PATTERN치수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	107ll /3Jig	c/sheet	재작업

Ver 1.0 (2009.05.07)





	제품			발행 /개정							관리번호	호 기인	<u> </u>	의	결정		
CHIP ANTENNA			Issued 04.04.06. Revised 05.04.03			품질관리공정도				PRCP-C001							
	FLOW	CHART					요인관리				품질특성관리						
투입자재	준비	본공정	공정명	설비명	관리형	항목	조건	관리주기	기록관리	검사항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록 관리	조치 사항		
			건조	건조기 건조Jig	온5 Belt sp		작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업		
			소부	소부로 mesh 망	온5 Belt sp		작업지도서 참조	1회/주	Parameter C/Sheet	소체파손 오염	작업지도서 참조	목시	전수	Lot card	폐기 재작업		
		\Diamond	외관검사							제품외관	한도견본 작업지도서 참조	목시 현미경	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리		
			MARKING	마킹기						마킹외관	한도견본	목시	전수	Lot card 생산일보	재작업 폐기		
		\Diamond	특성검사 CTF공정	NETWORK 검사지그	교정성	상태	작업지도서 참조	1회/반	C/sheet	전기적 특성	작업지도서 참조	Network	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리		
		\Diamond	외관검사							제품외관 제품치수	한도견본 작업지도서 참조	목시 현미경	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리		
Carrier cover reel			Taping							수량 역삽 외관	작업지도서 참조	수작업	전수	Lot card 생산일보	재작업		
		\Diamond	출하검사	NETWORK 검사지그	교정성	상태	작업지도서 참조	1회/반	C/sheet	전기적특성 제품외관 포장상태	검사지도서	Network 현미경 목시	작업 지도서	성적서	return 폐기		
포장 box label			포장	bar code printer						포장상태 기종혼입 포장수량	포장작업 지도서	목시	전수	-	재작업		
		\Diamond	포장검사							포장상태 기종혼입 포장수량	포장작업 지도서	목시	전수	-	return		

Ver 1.0 (2009.05.07)

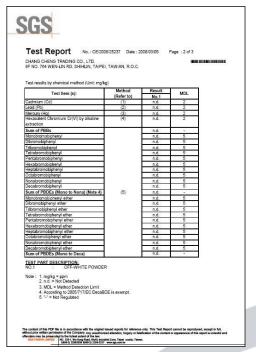


17. 유해물질 성적서

17.1 Ceramic Powder

Parts Name	White Powder(MMS-08)
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table





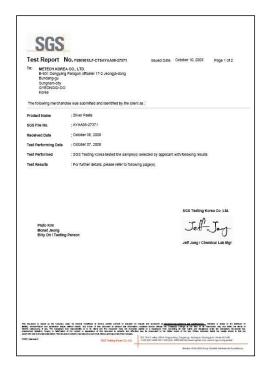


Ver 1.0 (2009.05.07) 29/31 page



17.2 Ag Paste

Parts Name	Silver Paste
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table



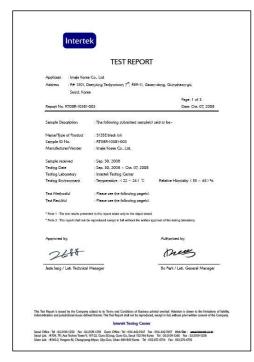


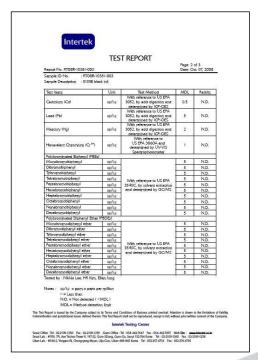




17.3 Marking Ink(Black Ink)

Parts Name	Black Ink
Tester Organization	Intertek Testing Center
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table







Ver 1.0 (2009.05.07) 31/31 page